

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : H01L 21/00, C25D 7/12		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/55888 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. September 2000 (21.09.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/01984		(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 8. März 2000 (08.03.00)			
(30) Prioritätsdaten: 199 11 084.0 12. März 1999 (12.03.99) DE			
(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): STEAG MICROTECH GMBH [DE/DE]; Carl-Benz-Strasse 10, D-72124 Pliezhausen (DE).		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(72) Erfinder; und			
(75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): KROEBER, Wolfgang [DE/DE]; Gartenstrasse 6, D-78166 Donaueschingen (DE).			

(54) Title: DEVICE FOR TREATING SUBSTRATES

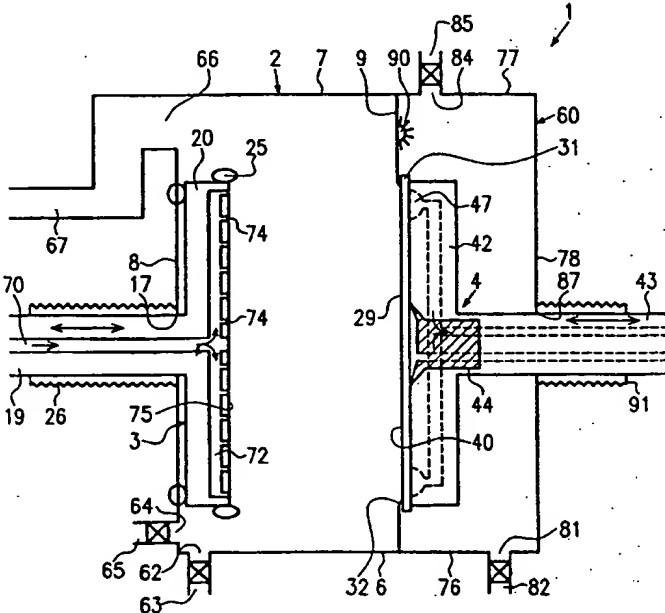
(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON SUBSTRATEN

(57) Abstract

The invention relates to a device for treating substrates, especially semiconductor wafers, with at least one processing container that is provided with an opening which can be closed from the exterior during the treatment with the substrate. The aim of the invention is to provide a simple and homogeneous treatment of a surface pertaining to a substrate. The aim of the invention is also to reduce the danger of damage between successive treatment steps. To this end, a second processing container is provided adjacent to the first processing container. The wall of said second processing container is at least partially the container wall of the first processing container, whereby said container wall is provided with the opening which can be closed from the side of the first processing container.

(57) Zusammenfassung

Bei einer Vorrichtung zum Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, mit wenigstens einem eine Öffnung aufweisenden Prozeßbehälter, wobei die Öffnung während der Behandlung durch das Substrat von außen schließbar ist, wird eine einfache und homogene Behandlung einer zu behandelnden Oberfläche des Substrats und eine Verringerung der Gefahr einer Beschädigung zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungsschritten dadurch erreicht, daß benachbart zum ersten Prozeßbehälter ein zweiter Prozeßbehälter vorgesehen ist, dessen eine Wand zumindest teilweise die die Öffnung enthaltende Behälterwand des ersten Prozeßbehälters ist und die Öffnung von der Seite des ersten Prozeßbehälters her schließbar ist.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						